泰晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

	□特定对象调研 □分析师会议
投资者关系活动	□媒体采访 □业绩说明会
类别	□新闻发布会 □路演活动
	□现场参观
	☑其他(电话调研)
参与单位名称	兴业证券、中欧基金、泰达宏利基金、财通资管、民生加银基
	金、深圳金华阳投资、华泰保兴基金
时间	2021年03月05日10:00-11:00
地点	董秘办公室
上市公司接待人	泰晶科技董事会秘书 黄晓辉
员姓名	
	一、公司情况介绍:
	2020年,公司实现营业收入 6.31 亿元,同比增长 8.84%;
	实现归属于母公司的净利润 0.39 亿元, 较上年同期上升
	239.24%, 实现扣非后归母净利润 0.22 亿元, 同比增长 188.49%,
	第四季度实现归母净利润 0.28 亿元,环比上升 370.25%。
投资者关系活动	公司产品涵盖 KHz(SMD K 系列和 TF 系列)、MHz(SMD
主要内容介绍	M 系列和 S 系列)、热敏(SMD T 系列)、TCXO 等全域产品。
	2020年总产量 22.80 亿只,同比减少 14.99%。其中下降较严重
	的是 TF 系列,产量同比下降 42.99%,主要受疫情影响,出口
	订单受阻,产能利用率下滑。
	但由于片式、小型化、高端新产品快速增长,较好的弥补
	了 TF 系列产品下滑对产值造成的影响。其中, SMD K 系列产
	品产量同比增长 85.75%, SMD M 系列产品产量同比增长

1

18.24%, SMD 热敏 T 系列产品产量同比增长 130.39%,整体片式产品产量同比增长 23.39%。受益部分产品价格上涨,SMD K 系列和 SMD 热敏 T 系列产品毛利率增长,公司主营业务综合毛利率达 21.25%,较上年同期上升 1.84%。

受国际形势影响,供应链自主可控上升到国家战略层面,公司持续推进方案商产品配套研发及平台认证,终端客户数量实现新增长。其中 KHz 晶振提供时钟频率,是 RTC 实时时钟电路中的核心关键器件,在消费类电子和工业控制等应用领域发挥重要作用,叠加小型化、即时唤醒、低功耗、低延迟等功能需求大幅增长,公司基于 MEMS 工艺的微型化 KHz 晶体谐振器优势突出,并积极布局产能扩充,获得歌尔、移远通信、京东方等大客户认可。2020 年,公司 SMD M 系列和 SMD 热敏 T 系列产品也拓展了诸多下游客户和应用场景,如通过高通骁龙、主流通讯模组厂商、优质方案商 Cat1-4 平台认证,拓展 WIFI6 等应用领域。

技术研发上,公司持续在新装备、新工艺、新产品上实现研发突破,部分高端核心设备实现自主研发及迭代,在工艺制程和高端产品上不断创新突破;小型化方面,基于激光调频和光刻技术十余年的技术沉淀,强化在小型化晶体产品规模化、产业化应用;片式化方面,2020年,公司片式产品产值比重达75.32%,较去年61.34%增加13.98%;高频化方面,近两年加大小尺寸AT、SC切高频点研发和量产,并将进一步加强小型化、微型化、片式化、高稳定性、高可靠性、高精度产品研发的投入力度。

二、问答环节:

1、公司产品涨价平均幅度如何?背后整体的驱动力,以及价格的持续性如何?

答: 2020 年, 部分产品涨价幅度 20%-50%左右, 不同产品对

应不同的价格上涨表现。产品价格上涨主要受原材料、生产成本、供求关系等综合因素影响,当前受中美贸易摩擦影响,供应链自主可控及产业链安全性提升到国家战略层面,国产替代进口加速需求向国内市场转移,叠加疫情原因造成的产业链缺货,推动公司优势产品价格提升空间。同时,下游应用场景包括 5G 及智能终端、智能家居、智能网关、可穿戴设备、智慧医疗、工业控制、物联网、通讯模组等新兴应用领域需求的快速增长,催生晶振需求量的增加。公司半导体光刻工艺技术的产业化应用并非一日之功,其工艺制程难度高,具备一定的技术壁垒,在供需紧张情况下,相关产品价格有所上涨。

2、四季度部分产品涨幅较大,在四季度业绩中是否有所体现? 答:产品产量,四季度相较三季度略有上升,高附加值产品的结构进一步优化,抵消了TF系列销量下滑对四季度营收端的影响,高附加值产品的量价齐升,带来了四季度净利润的增加。

3、公司未来产品产能规划情况如何?

答:公司 2019 年产量 26.81 亿只,2020 年产量 22.80 亿只,2021 年产能扩充,主要来自 SMD K 系列、SMD M 系列、SMD 热敏 T 系列产品的产能提升。TCXO 系列产品将基于市场需求的变化,进行一定的产能扩张和爬坡。而 TF 和 S 系列将保持现有的产能。

4、公司在行业中的竞争优势有哪些?

答:公司深耕频控器件行业十五年,在产业化水平、装备先进性、新产品研发等方面取得长足进步,跻身国际优秀企业之列。2019年,公司谐振器产值位列全球第九,且市占率仍在逐步提升;产品结构上,公司产品系列齐全,小型号产品逐步放量,尤其是 SMD K 系列产品,高频中 SMD M 系列 2016 及以下产

品在主营业务收入中的比重大幅提升, SMD 热敏 T 系列产品规模化量产;工艺上,公司积累了多项小尺寸晶片开发、元器件封装、测试等核心工艺技术,具备微型片式音叉、超高频晶体谐振器批量生产技术基础,MEMS 光刻工艺在国内率先实现产业化应用;装备上,部分高端核心设备自主研发、集成创新,并引进最新型生产设备,降低生产成本,提高生产品质与效率;客户上,持续强化方案商产品配套开发及平台认证,客户多元,资源丰富。

- 5、晶振在汽车电子上应用前景如何?公司如何布局?答:传统汽车向智能汽车发展,单车晶振需求从近 30 只向 70 到 100 只提升。同时汽车电子对晶振稳定性和精度要求更高,使用晶振单价也较高。公司已在汽车电子市场上进行规划,武汉作为公司市场部所在区域,将重点发展汽车电子客户的渠道布局。
- 6、热敏产品在手机终端有一定应用,目前进展如何? 答:公司热敏条线布局较早,2014年就在做相应产品的研发, 2017年可转债项目之一就用于热敏产线。从产品产能和产品成 熟度上优势较突出。热敏下游应用中,智能机是主要应用场景 之一,主要的方案商包括高通、联发科、紫光展锐均使用了热 敏晶振,如高通使用 38.4MHz 2016/1612 热敏晶振,联发科使用 了 26MHz 2520/2016 热敏晶振,紫光展锐使用 26MHz 2520 和 52MHz 2016 热敏晶振。公司已取得高通、联发科、紫光展锐部 分热敏产品认证,未来将更好的承接客户的产品需求。
- 7、光刻工艺在晶振的应用,对产业链价值和趋势? 答:晶振的核心是晶片,晶片中最精尖的技术是光刻工艺。公司已实现半导体光刻工艺在晶片上的产业化和规模化应用。目

	前日企也在专注更小型化晶片的研发,光刻是未来晶振产业链的技术趋势。
附件清单(如有)	无
日期	2021年03月05日